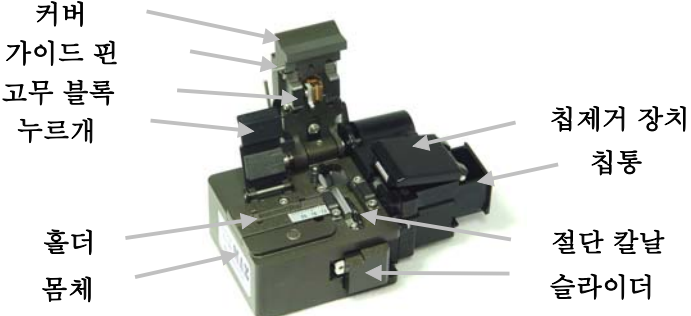
	<p>◆ 사용 시 안전수칙 및 주의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 사용하기 전에 이 취급 설명서의 내용을 충분히 이해한 후 사용한다. ◦ 취급 설명서는 항상 제품과 함께 보관한다. ◦ 사용 시 다음 사항에 주의하여 신체의 위험과 재산상의 손해를 미연에 방지하고 안전하고 유익하게 사용할 수 있도록 한다. ◦ 본 기기는 물이 젖지 않도록 주의하여 사용한다.
---	--

<ul style="list-style-type: none"> ◦ 습기나 먼지가 많은 장소에 보관하면 고장의 원인이 될 수 있으므로 적절한 장소에 보관한다. ◦ 본 제품은 고온에 의해 변형될 수 있으므로 상온에서 보관 및 사용한다. ◦ 본 제품은 진동 및 충격으로 인한 고장이 발생할 수 있으므로 주의하여 사용한다. ◦ 다심 Holder 교환 시 적절한 공구(1.5mm 육각렌치)를 사용한다. 또한 Holder 교환 시 볼트를 정확히 체결한다. ◦ 광섬유 절단 시 피복 제거 길이는 목표 절단 길이보다 최소 15mm이상 크게 한다. ◦ 본 기기 청소 시 고무 부위에 알콜 외 아세톤 등의 유기용제는 절대 사용하지 않는다.

◆ 제품의 구성 및 각부 명칭

구 성	
Cleaver MAX 조립체	
Fiber Holder(단심용)	
보 관 용 B O X	
취 급 설 명 서	
육 각 렌 치	

◆ 광섬유의 절단 작업 순서

본 제품(CI-03B)은 단심용 절단기이며, 클래드 직경이 125 μ m인 광섬유를 절단한다.

<p>1. 광섬유 외피의 종류(Jumper Cord, Bare Fiber)에 상관없이 절단이 가능하다.</p>		<p>2. 광섬유의 절단을 위해 절단기의 덮개를 열고 탈피된 광섬유를 절단 길이에 맞추어 안착한다.(이때 칩 배출이 용이하도록 광섬유의 탈피 길이를 25mm이상 32mm이하로 한다.)</p>	
<p>3. 절단기의 덮개를 닫으면 자동으로 광섬유가 절단된다. ※ 확실한 절단을 위해 1차로 덮개를 천천히 PUSHER PIN 까지 덮는다.</p>	 	<p>※ 2차로 덮개에 힘을 실어 눌러주면 슬라이더가 이동하면서 광섬유가 절단된다.</p>	

<p>4. 커버를 열고 절단된 광섬유를 주의하여 탈거한다.(광섬유에 먼지나 이물질이 묻지 않도록 주의한다.)</p>		<p>5. 절단된 칩은 커버를 열 때 칩제거 장치에 의해 자동으로 버려진다.</p>	
<p>6. 칩통에 광섬유 찌꺼기가 찰 경우 칩제거 장치로부터 칩통을 분리하여 절단된 칩을 제거한다.</p>			

◆ 절단 칼날 조정 및 교환법

1. 절단 칼날에는 1~16까지의 절단위치가 표시되어 있다.
2. 정상적인 절단이 되지 않을 때는 절단칼날의 날 부위 및 상하 고무 Pad를 알콜을 적신 면봉으로 청소해 준다. (단, 고무 Pad 청소시 아세톤, 솔벤트등의 사용을 금한다.)
3. 그래도 절단이 안 될 경우에는 절단칼날의 수명이 다 됐으므로, 절단칼날의 위치를 변경하여 준다. (절단칼날의 수명 : 48,000)
4. 절단칼날의 Setting은 다음 순서에 의해 절단칼날을 조정해 준다.

A. 절단칼날의 절단부위(1~16) 변경방법

<p>1. 먼저 칩제거 장치의 칩통을 절단기에서 분리한다.</p>	 <p style="text-align: center;">칩통</p>	<p>2. 몸체 바닥에 삽입되어 있는 렌치를 꺼낸다.</p>	
<p>3. 본체 덮개를 열면 절단날 조립체가 움직인다. 덮개를 열어 그림과 같이 내부나사와 CAM이 보이도록 하여 움직이지 않도록 고정한다.</p>	 <p style="text-align: center;">조립체 내부나사 CAM</p>	<p>4. 칩제거 장치 내부의 셋트스크류를 육각 렌치로 적당히 풀어준다.</p>	
<p>5. 면봉으로 절단날의 눈금숫자가 크게 되도록 반시계 방향으로 한 눈금씩 돌려준다.</p>		<p>6. 조립은 역순으로 실시한다.</p>	

※ 1~16까지 모두 사용한 절단 칼날은 교환하여야 한다. 칼날 교환은 “B. 칼날 교환 및 높이 조정 방법”을 참조한다.

B. 절단칼날 교환 및 높이 조정 방법

<p>1. 먼저 칩제거 장치의 칩통을 절단기에서 분리한다.</p>	 <p style="text-align: center;">칩통</p>	<p>2. 몸체 바닥에 삽입되어 있는 렌치를 꺼낸다.</p>		<p>3. 본체 덮개를 열면 절단날 조립체가 움직인다. 덮개를 열어 그림과 같이 내부나사와 CAM이 보이도록 하여 움직이지 않도록 고정한다.</p>	 <p style="text-align: right;">조립체 내부나사 CAM</p>
<p>4. 칩제거 장치 내부의 셋트스크류를 육각 렌치로 적당히 풀어준다.</p>		<p>5. 그림과 같이 제품의 바닥 면의 셋트스크류를 적당히 풀어준다.</p>		<p>6. 바닥면의 렌치 볼트를 캠에 돌려 넣은 다음 집게로 볼트를 당겨내어 캠을 슬라이더에서 탈거한다.</p>	
<p>7. 칼날을 몸체 상부 쪽으로 탈거하여 교환한다. 이때, 칼날에 손상이 가지 않도록 극도로 주의한다.</p>		<p>8. 새로 준비한 블레이드를 분해 역순으로 조립한다.</p>		<p>9. 블레이드 위치를 적당히 조절하면서 캠(CAM)을 밀어 넣는다.</p>	
<p>10. 칩제거 장치 내부의 셋트스크류를 육각 렌치로 적당히 조인다.</p>		<p>11. 칼날 높이를 조정하기 위해 그림과 같이 다이얼 게이지를 절단기의 편평한 옆면 위에 올려놓는다.</p>	 <p style="text-align: center;">다이얼 게이지 포인트 절단기 몸체</p>	<p>12. 다이얼 게이지 영점 커버를 좌우로 움직여 영점을 맞춘다.</p>	 <p style="text-align: right;">다이얼 게이지 영점 커버 - 방향 + 방향</p>
<p>13. 그림과 같이 다이얼게이지를 절단기의 고무 블록 위에 올려놓고 블레이드 슬라이더를 전 후로 밀면서 블레이드의 높이를 측정한다.</p>	 <p style="text-align: center;">블레이드 슬라이더</p>	<p>14. -자 드라이버로 캠 (CAM)을 시계 방향으로 한 눈금 돌려준다. 칼날 높이를 0.04~0.06mm로 조정한다. (리본 광섬유의 경우 0.08~0.10mm로 조절한다.)</p>	 <p style="text-align: center;">다이얼 게이지 포인트 절단기 고무 블록 블레이드</p>	<p>14. -자 드라이버로 캠 (CAM)을 시계 방향으로 한 눈금 돌려준다. 칼날 높이를 0.04~0.06mm로 조정한다. (리본 광섬유의 경우 0.08~0.10mm로 조절한다.)</p>	
<p>15. 칩제거 장치 내부의 셋트스크류를 육각 렌치로 조인다.</p>		<p>16. 그림과 같이 제품의 바닥 면의 셋트스크류를 조인다.</p>		<p>17. 칩통을 칩제거 장치의 홈 안으로 밀어 넣는다.</p>	

※ 주 의 : 제품의 수리를 위하여 볼트 및 기타 고정 구를 절대 만지지 마십시오.